

### 小型チップ用高速ダイボンダを発売 －日立ハイテクインスツルメンツ製半導体組立装置－

株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：久田 眞佐男／以下、日立ハイテク）は、100%製造子会社である日立ハイテクインスツルメンツ（取締役社長：光用 豊）製の高速ダイボンダ「DB-900」を発表し、今後積極拡販してまいります。

ダイボンダは、半導体組立のダイボンディング工程に使用される装置で、ダイシングされたウェーハよりチップを取り出し、リードフレームや基板などのインターポーザーに搭載して使用します。

現在、携帯機器の小型・高機能化に伴い、半導体も小型化・搭載数の増加が加速しております。ウェーハサイズも従来の6・8インチから12インチへの大型化が進んでおり、組立装置へもさらなる生産性の向上が求められています。

日立ハイテクでは、すでにDRAM専用装置である「CM700シリーズ」、及びNAND型フラッシュメモリー用途で「DB-700/800」をラインナップしており、高生産性、高安定性を市場から高く評価いただいております。このたび、メモリー市場で実績のある12インチ対応および高安定稼働技術をベースに、新設計の高速ボンダヘッドを搭載したミドルエンド品組立市場に向けた「DB-900」を開発いたしました。小型チップ対応機として0.15mm角も視野に入れ、高速リニアモータ駆動や高速ペースト塗布システムを採用し、UPH18,000（\*）の高生産性を実現しています。

本製品の主要市場となる、アナログデバイスや汎用マイコン、通信用デバイスなどの組立市場は、中国や東南アジアに集中しており、これらの地域でマーケティングを強化、拡販を目指します。

なお、本製品はセミコン・ジャパン 2011（会場：幕張メッセ／2011年12月7日～9日）に出展予定です。

日立ハイテクは今後とも、メモリー向けダイボンダ市場におけるグローバルトップ企業として、同じく市場が急拡大している小型チップの汎用ロジックパッケージ（主にQFN（Quad Flat Non-lead）パッケージ）市場にも積極参入し、ダイボンダのラインナップ充実化を通じてあらゆる半導体パッケージニーズに対応し、一層のシェアアップを図ってまいります。



日立ハイテクインスツルメンツ製高速ダイボンダ「DB-900」

（\*）UPH（Unit Per Hour）18,000：従来比200%向上

#### ■お問い合わせ先

電子デバイスシステム事業統括本部 実装システム営業本部 実装システム三部 担当：織田  
TEL：03-3504-7730

#### ■報道機関お問い合わせ先

CSR本部 コーポレート・コミュニケーション部 担当：松本、武内 TEL：03-3504-3258